



Integrated Device Technology

The Analog and Digital Company™


[Products](#) | [Applications](#) | [Search](#) | [Support](#) | [Investor](#) | [About IDT](#)
[Processor Products](#) [EHB \(Embedded Host Bridges\)](#) [PowerSpan II™](#) [CA91L8260B](#) [CA91L8260B-100CEV](#)
CA91L8260B-100CEV
[Description](#) | [Parameters](#) | [Package](#) | [Documents](#) | [Distributor Inventory](#) | [Contacts](#)
Customer Support / Technical Support**DESCRIPTION**

PowerSpanII Single

Generic Part:

[CA91L8260B](#)

Category:

[PowerSpan II™](#)**PARAMETERS**

Package	TEPBGA 420
Speed	100 MHZ
Temperature	C
Voltage	2.5V/3.3V
Memory Interface	No - Use PowerPro
PCI Interface	
Pkg. Dimensions	
Secondary Masters	
Other Ports	
Power (Max & Typical)	
Processors Supported	

PACKAGE

Package	TEPBGA 420 (AEG420)
Description	THERMAL 35.0 X 35.0 MM X 1.27 MM PITCH
Status	Active
Class	PLASTIC
Category	Green
Pb (Lead) Free	Yes
Pb Free Category	e1 SnAgCu
Mark	EV
Package Type	TEPBGA
Lead Count	420
Length	35.0 mm
Width	35.0 mm
Thickness	2.33 mm
Pitch	1.27 mm
Tube / Tray	TRAY
Quantity per Tube/Tray	24
Quantity per Reel	N/A
Moisture Sensitivity Level (MSL)	3
Moisture Exposure Floor Life	168 hrs@<30C/60% RH
Peak Reflow Temperature	260°C
Rebake Conditions	48hrs@125C
Related Package Documents	view documents

DOCUMENTS

Type	Title	Size	Revision Date
Application Note	PowerSpan II Initialization Application Note	72 KB	11/09/2009
	Interfacing the PowerSpan II with the Wintegra WinPath	235 KB	11/04/2009
Device Errata	PowerSpan II Device Errata and Design Notes	88 KB	11/04/2009
Manual - User Reference	PowerSpan II User Manual	2019 KB	11/05/2009
Misc	PowerSpan II Pinlist (420 BGA)	7 KB	11/05/2009
	PowerSpan II Pinlist (480 BGA)	8 KB	11/05/2009
	PowerSpan II Schematic Review Checklist	107 KB	09/09/2009
	PowerSpan II BSDL File (420 BGA)	39 KB	09/09/2009
Model - BSDL	PowerSpan II BSDL File (484 BGA)	39 KB	09/09/2009

Model - IBIS	PowerSpan II BSDL File (504 BGA)	53 KB	09/09/2009
	PowerSpan II IBIS Model (420 BGA)	15 KB	09/09/2009
	PowerSpan II IBIS Model (480 BGA)	17 KB	09/09/2009
Product Brief	PowerSpan II Product Brief	84 KB	10/28/2009
Product Change Notice	PCN# : A1006-02 Heat Spreader Appearance Change on TEPBGA-420 & TEPBGA-675	130 KB	07/26/2010

DISTRIBUTOR INVENTORY

Part	Distributor	Qty	Date	RFQ	Order
No matches found.					

CONTACTS

Sales Offices

- [Sales Offices and authorized distributors](#)

Technical Support

Enhanced Host Bridges (EHB)

- WWW: www.IDT.com/?app=TechSupport
- Phone: (408) 360-1538

Host Bridges

- WWW: www.IDT.com/?app=TechSupport

VME

- WWW: [Customer Support / Technical Support](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9